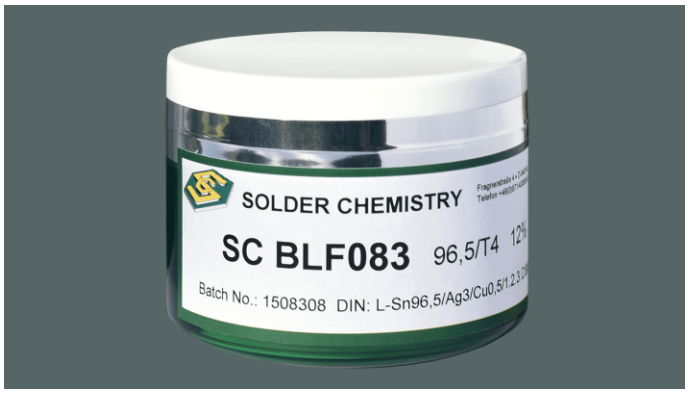
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



SC BLF083 96,5/Ag3/Cu0,5/T4 12/02 Dose 500g

Artikel-Nr:	1592141202	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 124.80

Beschreibung

Die Lotpaste SOLDER CHEMISTRY BLF083 ist konsequente Weiterentwicklung im Hinblick auf unwiderruflich eingeführte bleifreie SMT-Lötprozesse und dem Kundenwunsch nach einer leichter druckbaren und sehr lange klebenden Paste, um die teils tagelangen Stillzeiten zwischen Drucken und Bestücken überbrücken zu können und dazu sehr geruchsarm sein. Dabei sollen unsere „Markenzeichen“ d.h. minimalste Rückstände auf der PCB, die dicht an der Lötstelle nach dem Löten verbleiben, lunkerfreie Lötstellen, keine Kühlschranklagerung behalten werden. Die Verwendung von neusten Typen von modifizierten Kunststoffen und Rheologiezusätzen bei der Lotpaste und die daraus resultierende, sehr gute Kombinationsmöglichkeit mit bleifreien Legierungen, sowie die neuesten Erkenntnisse in der SMT haben zu dieser Weiterentwicklung beigetragen. Eine sorgfältige und strenge Beachtung der Richtlinien von ISO-, EN-, IPC- und MIL-Normen lag auch ihr selbstverständlich zugrunde. Die BLF083 ist physikalisch gesehen eine gleichmässige Mischung aus einem bleifreien Lotpulver, in allen erforderlichen Legierungen und Körnungen lieferbar, mit einem organischen Bindemittel auf Kunstharzbasis, das der Kl. RE L0 nach DIN EN61190-1-1 oder RMA-Qualifizierung entspricht.

Technische Daten

- Exzellente Resistenz gegen Feuchtigkeit. Tagelange Klebrigkeit!!!
- Bildet sehr homogene, lunkerfreie Lötstellen!
- Lötet hervorragend, auch auf leicht korrodierten Oberflächen. (QFN-Form!)
- Die Rückstände sind absolut halogenfrei. (RE L0 Klassifizierung)
- Eine nochmals verbesserte Druckqualität, wie bereits gewohnt!
- Hinterlässt natürlich keine teerartigen Rückstände in der Lötanlage.
- Minimalste, kaum sichtbare Rückstände. Keine Lötperlen.

Zusätzliche Information

Hersteller	SOLDER CHEMISTRY
Bleihaltig	Nein
Flussmittel	REL0
Gebinde	Dose
Gebindegrösse (g)	500

Korngrösse	4
Haltbarkeit	26 Wochen
Legierung	Zinn/Silber/Kupfer
Schmelztemperatur (°C)	217